

發佈混合記憶體立方體介面規範 初稿

業界領導計畫在今年底完成其
最終規範

愛達荷州博伊西和加州聖荷西，2012年8月15日（GLOBE NEWSWIRE）-- 由 Micron Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：MU）和 Samsung Electronics Co., Ltd. 領導的混合記憶體立方體聯盟（HMCC），今日宣佈其開發成員已向快速增長的業界採用者發佈混合記憶體立方體（HMC）介面的初步草案。該草案的發行使聯盟能夠在年底如期發佈其最終版本。HMC 的創新技術具有提高多種應用性能的潛力，該行業規範將使採用者可以充分利用該創新技術進行開發設計。

該初步草案包含一個介面協定和針對高性能網路、工業、測試和測量應用的跨實體層（PHY）短距離互聯。規範開發的下一階段要求聯盟的採用者改進規範並為要求緊耦合或臨近記憶體支援的 FPGA、ASIC 和 ASSP 應用定義一個超短距離實體層。

“在現有的讓採用者用於最終輸入和修改的標準草案的基礎上，我們期望能夠更近一步，使混合記憶體立方體以及最新一代 28 納米 FPGA 可以方便地被集成到高性能系統中。” Altera 的架構師 Rob Sturgill 說到。“該聯盟成員企業之間在定義新標準上取得的穩步進展，預示著企業願意將混合記憶體立方體納入自己的產品戰略以達到前所未有的系統性能和頻寬。”

該介面規範反應了許多世界領先的技術供應商共同關注的焦點。Micron 和 Samsung 是 HMCC 的初始開發者，與 Altera Corporation、ARM、HP、IBM、Microsoft Corporation、Open-Silicon, Inc.、SK hynix Co.以及 Xilinx, Inc.一起緊密合作，為推動多種電子產品的進步鋪平道路。

“作為同時面臨滿足爆炸式增長的頻寬需求和保持力所能及的預算挑戰的系統設計者，Xilinx 致力於研究在解決系統瓶頸的同時又可將能耗保持在可接受水準內的技術，” Xilinx 投資組合及解決方案行銷副總裁 Hugh Durdan 說到。“因為其越來越重要的作用，因此，在 HMC 規範上取得的進展對於 Xilinx 來說是非常令人激動的，這使我們的 28 納米高性能、低能耗 FPGA 可以在高性能系統上發揮作用。”

預期 HMC 將在性能、封裝和能耗領域超越當前和近期的記憶體架構，使當前記憶體技術產生重大轉變。

行業面對的主要挑戰以及形成 HMCC 的關鍵因素是：傳統記憶體結構已無法有效提供高性能電腦和下一代網路設備所需的記憶體頻寬。

術語“記憶體壁壘”被用於描述該挑戰。打破記憶體壁壘需要諸如 HMC 之類的架構，可以提供不斷增長的密度和頻寬，同時顯著降低能耗。

任何有意參與開發該規範的公司都可獲得 HMCC 採用者成員資格。HMCC 已回應了超過 115 位准採用者。計畫在 2012 年底完成並發佈該介面規範的最終版本。

可以在 www.hybridmemorycube.org 找到採用該技術的其他資訊、技術支援和工具。

關於 HMCC

混合記憶體立方體聯盟（HMCC）由世界領先的半導體成員創建，致力於開發和建立混合記憶體立方體技術的行業標準介面規範。其成員包括 Altera Corporation、ARM、HP、IBM、Micron Technology、Microsoft Corporation、Open-Silicon, Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、SK hynix Co.以及 Xilinx, Inc.。還有超過 115 家准採用者力爭成為聯盟成員。欲瞭解有關 HMCC 的更多資訊，請訪問 www.hybridmemorycube.org。

聯繫方式： Scott Stevens

Micron Technology, Inc.
+1.512.288.4050
sstevens@micron.com

John Lucas
Samsung Electronics Co., Ltd.
+1.408.544.4363
j.lucas@ssi.samsung.com